(주)진우테크

제89차 정밀 연마 전처리 교육

Parallel Thinning for Die & Package Analysis

교육대상

▶ **대 상 :** 각종 소재 및 부품 TEM, EBSD, SIMS, AFM 등 시편제조를 위한 정밀 연마 시편전처리 반도체 및 Backside Delayering 등 기술이 필요하신 분

▶ **내 용 :** 시편전처리 기본 교육 및 MultiPrep, Diamond wire Cutter 등 시편전처리 장비를 활용 (시편 준비 시 직접 사용 가능)하여 실습함

교육일정 및 비용

▶ **일 시 :** 2021년 12월 09일 (목) 오전 10시

▶ **참가인원 :** 선착순 6명

▶ **참가비용 :** 10만원/1일

- 대학, 대학원생 무료
- ALLIED 장비 사용자 무료

▶ **강 사 :** 센터 책임 및 담당 연구원

교육일정	세부내용
10:00 am ~ 10:50 am	**시편 전처리 이론 및 MultiPrep & X-Prep System**
11:10 am ~ 11:50 am	**Equipment Calibration**
12:00 pm ~ 01:00 pm	**점심식사**
01:15 pm ~ 02:40 pm	**Sample 제작 1**
03:00 pm ~ 06:00 pm	**Sample 제작 2**

※ 교육참가를 희망하시는 분이나 시편이 있으신 분들은 시편 전처리센터 (031-777-1277 / 010-7566-1278)로 문의 바랍니다.

주소: 경기도 성남시 중원구 둔촌대로474, 선텍시티 1차 507호 (상대원동)
Fax: 031-777-1288 | E-mail: info@chinwoo.co.kr | Web site: http://www.chinwoo.co.kr